

广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于 2020 年度董事会工作报告的议案

2020 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极推动公司各项业务的发展。以下为公司 2020 年度具体董事会工作报告：

一、2020 年度董事会主要工作情况

2020 年，董事会共召开 10 次董事会会议，会议情况及决议内容如下：

（一）董事会会议情况及决议内容

1、2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过：

- （1）《关于公司向全资子公司广州创想云科技有限公司提供担保的议案》；
- （2）《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过：

- （1）《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
- （2）《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；
- （3）《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
- （4）《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
- （5）《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
- （6）《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- （7）《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保的议案》；
- （8）《关于 2020 年第一季度报告的议案》；
- （9）《关于会计政策变更的议案》；

(10) 《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》;

(11) 《关于 2020 年度银行贷款授信额度授权事宜的议案》;

(12) 《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》;

(13) 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》;

3、2020 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过:

(1) 《关于投资设立全资子公司的议案》;

(2) 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》;

4、2020 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十四次临时会议, 审议通过

(1) 《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》;

(2) 《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》;

(3) 《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》;

(4) 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;

(5) 《关于对全资子公司惠伦晶体(重庆)科技有限公司增资的议案》;

(6) 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;

(7) 《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》;

(8) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

5、2020 年 7 月 30 日召开第三届董事会第十五次临时会议, 审议通过:

(1) 《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》;

(2) 《关于签署项目投资协议暨确定项目公司的议案》;

(3) 《关于关联交易追认的议案》;

(4) 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;

(5) 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;

- (6) 《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》;
- (7) 《关于公司向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》;
- (8) 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
- (9) 《关于 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》;
- (10) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
- (11) 《关于设立募集资金专项账户的议案》;
- (12) 《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》;
- (13) 《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈向特定对象发行股票认购协议〉的议案》;
- (14) 《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》;
- (15) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行工作相关事宜的议案》;
- (16) 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》;
- (17) 《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》。

6、2020 年 9 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过：

- (1) 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》;
- (2) 《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》;
- (3) 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》;
- (4) 《关于公司 2020 年向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》;
- (5) 《关于 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》;

(6)《关于终止公司与认购对象签署附条件生效的〈向特定对象发行股票认购协议〉的议案》;

(7)《关于预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》;

(8)《关于修改〈公司章程〉的议案》;

(9)《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》;

(9.1)《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;

(9.2)《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;

(9.3)《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;

(10)《关于修订公司部分管理制度的议案》;

(10.1)《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

(10.2)《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

(10.3)《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

(10.4)《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

(10.5)《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

(10.6)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

(10.7)《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

(11)《关于调整关联租赁支付日期的议案》;

(12)《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

7、2020 年 9 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过：

(1)《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8、2020 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过：

(1)《关于公司向银行申请授信的议案》;

9、2020年10月22日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过：

- (1)《关于公司2020年第三季度报告的议案》；
- (2)《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。

10、2020年11月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过：

- (1)《关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的议案》；
- (2)《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》；
- (3)《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

2020年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

二、2020年公司经营回顾

2020年注定是不平凡的一年。一场突如其来的新冠疫情席卷全球持续至今，我国曾因疫情按下暂停键；以美国为首的西方主要国家对我国接连发起贸易战、科技战，又给我国乃至世界经济前景蒙上了一层厚厚的阴影，给公司的经营发展带来了极大不确定性。面对种种影响和困难，公司按照2020年度公司经营发展方针及目标，审时度势抓机遇，全力以赴夯基础，逆势突围保业绩，为公司迎接新一轮的持续快速发展提供了重要保障。

(一) 审时度势抓机遇，公司经营快速复苏

2020年，得益于5G及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，以及公司经营策略的转变与多年沉淀积累的产品、技术优势，公司订单持续增加，TCXO振荡器、TSX热敏晶体等部分产品价格上涨，产能利用率得到大幅提升，经营呈现良好复苏态势，其中：实现营业收入38,784.05万元，同比增长25.13%；利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润分别为2,023.51万元、2,020.17万元和2,020.17万元，实现了扭亏为盈的目标。

从产品结构看，2020 年度公司电子元器件业务营业收入 34,899.25 万元，占营业收入 90.43%，同比增长 33.52%，其中，小型化产品的销售收入 22,051.81 万元，占电子元器件业务营业收入的 63.19%，同比增长 34.64%；器件产品的销售收入 11,503.65 万元，占电子元器件业务营业收入的 32.96%，同比增长 85.55%。2020 年度创想云系统集成产品和技术服务实现营业收入 3,884.80 万元，较上年同期减少 20.01%。

（二）全力以赴夯基础，公司内生动力持续增强

2020 年是公司经营发展极为关键的一年，既要扭转两年亏损的局面，又要布局扩规模以抢占 5G、物联网市场及国产替代先机。因此，公司全方位夯实自身基础显得尤为重要。2020 年，公司不仅从研发、采购、生产、销售等经营层面各环节加大了运营管理力度，而且从人力、物力、财力等资源层面做了充足的准备与布局，公司内生发展动力持续增强。

经营层面

（1）研发环节。公司一直以来秉持创新驱动的发展理念，不仅立足行业前沿技术，加强新技术、新产品的开发，并且以市场为导向，支撑新技术、新产品的产业化，从而形成“开发为起始点，量产为落脚点”的研发机制。2020 年，公司围绕“小型化、高基频”的行业发展主旋律持续进行研发，在新技术方面既攻克了更小尺寸（例如 1210 尺寸）、高基频（例如 76.8MHz、96MHz）晶片生产的光刻相关技术，包括光刻减薄技术、激光隐形切割技术等，还突破了小尺寸 TCXO 振荡器（例如 1612 尺寸）搭载晶片与 IC 的特殊基座设计技术等难题，从而实现相关小尺寸、高基频元器件产品的研制，同时具备了相关产品量产的能力。

（2）采购环节。鉴于成本控制、新冠疫情及贸易战可能给产业链造成较大影响等因素的综合考虑，2020 年公司在采购环节采取了有力措施以确保基座、IC 等核心原材料的安全有效采购：一是进一步加强与核心原材料供应商之间的联合开发并建立战略合作关系，例如，公司与潮州三环、日本 NPC 公司分别就基座、TCXO 用 IC 进行了联合开发；鉴于友好合作关系，日本 AKM 公司即使在 TCXO 用 IC 供货紧张的情形下仍将公司列入优先供货对象。二是提升市场环境变化预判能力，结合公司在手订单及意向订单等情况科学制定采购频率和数量。

(3) 生产环节。伴随着 5G 及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，下游市场回暖迹象明显，在此背景下，提升产能和产量成为了公司 2020 年及未来在生产方面所面临的主要瓶颈。为有效解决产能和产量瓶颈，公司主要从两个方面着手相关工作的开展：一方面从增量角度实施扩产，分别在重庆和陕西设立全资子公司、合资公司，作为扩大生产规模的重要布局；另一方面从存量角度持续进行生产设备的“自动化、信息化”及技术改造，相关产品的生产效率和产品良率不断提升，产能和产量亦快速增长。

(4) 销售环节。2020 年，在中美国际贸易摩擦进一步加剧和顺应国产替代的背景下，为提升公司产品市场占有率及有效消化未来扩产新增产能，公司重点开展以下营销相关工作：一是加强产品在相关 IC 设计及应用方案平台的认证工作，实时跟进相关 IC 设计及应用方案变化的趋势和节奏，力争从源头把握市场机会。截至 2020 年底，公司已取得高通、英特尔 (Intel)、联发科 (MTK)、海思、展锐、络达 (Airoha)、恒玄 (BES)、瑞昱 (Realtek)、翱捷科技 (ASR)、移芯、芯翼等多个平台和方案商对于多项产品的认证，其中，1612 及 2016 尺寸 38.4MHz 热敏晶体谐振器 1Z38400002、9Z38400002 于 2020 年通过高通的产品认证许可，成为 1612 小尺寸及 2016 小尺寸热敏产品全球范围内通过高通认证的几家晶体供应商之一，同时也是国内首家量产并通过高通公司认证的晶体供应厂商。二是注重各领域标杆品牌客户的拓展与储备。2020 年，公司通过直接或代理商向闻泰科技 (600745)、移远通信 (603236)、汇川技术 (300124)、日海智能 (002313)、美格智能 (002881)、共进股份 (603118)、360 (601360)、卓翼科技 (002369)、小米通信、富士康、上海龙旗科技股份有限公司、海信集团有限公司、普联技术有限公司、英特尔 (Intel)、三星、韩国 LG 等批量供货；积极对接华勤通讯技术有限公司、立讯精密 (002475)、歌尔股份 (002241)、亚马逊等客户。三是加大力度建设国内营销网络，提高国内销售比重。2020 年度，公司国内销售收入达 23,267.23 万元，较上年同期增长 48.63%，占营业收入比重由上年的 50.51% 提升至 59.99%。

2、资源层面

(1) 人力方面。公司拥有一支行业经验丰富的管理人才和技术人才团队。一方面，公司注重内部优秀人才的培养，鼓励员工创新；另一方面，公司大力引

进外部高端人才，丰富人才储备。截至 2020 年底，公司拥有技术人员 237 人。与此同时，为充分调动公司高层管理人员及相关员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于 2020 年根据相关法律法规针对共 32 名激励对象实施了限制性股票激励计划，效果明显。

(2) 物力方面。继重庆全资子公司设立后，公司与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，通过重庆子公司在重庆万盛经开区投资建设基于半导体工艺新型高基频超小型频率元器件项目。该项目计划投资总额约 12.38 亿元，总建设周期 5 年分三期实施，主要用于生产小尺寸高基频压电晶体频率元器件产品，以满足 5G 和物联网对小尺寸、高频化晶体频率元器件产品的需求，实现高、中端谐振器、振荡器的进口替代。截至 2020 年底，该项目已完成约 87 亩工业用地的购置，并开始第一期基建的动工建设及设备的预购，为公司后续扩大规模奠定了坚实的物质基础。

(3) 财力方面。2020 年为了确保重庆项目顺利启动和实施，公司一方面在重庆当地政府的支持下与当地银行等金融机构建立友好合作关系，争取银行授信及其它融资来源，另一方面充分利用资本市场的融资功能，启动向特定对象发行股票拟融资不超过 5 亿元资金的方案。银行授信方面，基于对公司重庆项目未来快速持续发展的信心，中国银行綦江支行向公司提供了 1.06 亿元的项目贷款，支持重庆项目提前实施；向特定对象发行股票方面，相关事项进展顺利，预计 2021 年 4 月完成资金的募集。

三、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业发展趋势

2020 年，国际贸易摩擦进一步加剧，贸易保护主义抬头，新冠肺炎疫情尚未得到有效控制，外部宏观环境瞬息万变。尽管短期内整体市场发展存在较大不确定性，但随着 5G 及物联网时代的来临及相关产业的不断创新，全球电子信息产业将持续得到发展动力的注入，电子信息产业长期发展的趋势不变，公司所在行业亦将受益于 5G、物联网等市场应用领域需求增长而呈现持续发展态势。根据中国联通网络技术研究院预测，到 2024 年，中国 5G 用户将突破 10 亿户，到

2025年，中国5G用户渗透率将达到90%以上。随着5G的大规模商用，未来内容不仅分发到手机，还将分发到更多智能终端上，包括可穿戴设备、AR/VR设备、多功能笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能可交互电视、物联网硬件等。在此发展趋势下，压电晶体频率元器件作为各类智能终端的核心部件也因为5G、物联网时代的到来而引发巨大的市场需求。

与此同时，机遇与挑战并存，在中美贸易战背景下，国内知名通讯、整机、家电厂商为了保障产业链安全，积极在国内电子元器件行业寻求国产替代，促使高基频、小型化压电石英晶体元器件的中高端产品进口替代加速。根据中国海关数据，2017年至2020年1-8月，已装配的压电晶体进口金额分别为343.53亿元、414.73亿元、365.19亿元和241.73亿元，从某种角度看，这亦体现了压电石英晶体元器件相关产品进口替代市场的广阔空间。

（二）公司发展战略

公司致力于打造成为全球先进的“频率控制与选择”压电石英晶体元器件供应商的发展目标不变，始终坚持立足行业前沿技术，紧抓5G商业化、物联网产业快速发展及国产化替代等历史发展机遇，坚定不移地确保技术与产品在小型化、薄型化、高频化等方面国内同行的领先地位，缩小与国际同行的差距。

（三）公司2021年的经营计划

2021年是公司踏上新征程、翻开新篇章的开始。公司在2020年审时度势抓机遇、全力以赴夯基础的努力下将会迎来新一轮的持续快速发展期。如何确保在此轮机遇当中顺利实现持续快速发展将是公司2021年的工作重点。对此，公司将重点采取以下保障措施：

一是加强管理。一方面是加强对子公司尤其重庆子公司的全方位管理，确保项目扩产顺利进行；另一方面是在公司规模不断扩大的情况下提升财务管理与规划在成本费用控制的指导功能，逐步推动精细化管理在公司内部的运用。

二是加强研发。继续围绕5G、物联网时代对产品在小形化、薄型化、高频化等方面的要求，加强半导体光刻工艺相关技术的研发，确保高频化产品产业化顺利进行，力争促使公司成为国内首家实现高频化产品量产的企业。

三是加强销售。继续将产品的平台认证作为把握市场机会的重要突破口，加大下游知名优质大客户的拓展力度，推动高频化产品快速成为公司新的利润增长点。

董事会将继续发挥领导决策作用，进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度的管理和监督，促进公司业务不断发展，保护股东利益。

特此报告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日